



2025 年法人說明會 投資人提問及公司回覆重點

會議日期及時間

2025 年 12 月 15 日

台北時間 下午 2 點 30 分

Q1: 板材成本持續上升，公司如何維持毛利率？

針對此議題，因應市場競爭加劇，目前我們目前正在進行下列兩項主要工作：

1. 工廠端重新啟動檢討工程設計及量產各作業流程，持續引進自動化及各製程新一代設備。

諸如以雷射曝光機、雷射感光覆膜及自動化電測及檢驗設備等等，除提高生產效率外亦持續降低生產人力需求。

設計端則持續再優化檢討新機種的工程排版及製作流程設計，杜絕成本浪費並朝降低作業時數努力。

2. 已成交的客戶群維持現連工帶料的配合模式，後續業務開發的重點將放於空板出貨的新客戶，空板交貨模式除增加工廠端前段製程的稼動率外，亦將能降低目前連工帶料的營運負擔。

另外醫療產業用板及用線雖訂單數量較小，但目前所評估的是其毛利率將高於一般消費電子產業，所以我們今年與美西代理商簽訂了合作協議，希望於 2026 年能開始增加醫療產業的營收比重。

Q2: 高頻高速實驗室設置後，目前高頻產品的開發進度？

高頻高速實驗室成立後，研發活動已明顯加速。根據今年累計的模擬與量測資料顯示，已完成上百件(163 件)高頻高速相關設計模擬與實際量測驗證工作。

從開發的結構來看，終端應用仍以 筆記型電腦佔 82.8% 為主，其次是平板及工業電腦等多元裝置。材料使用方面，以 MPI 材料採用率最高（62%），顯示其在性能與成本間取得良好平衡；同時我們也已投入 LCP 材料（5.5%）的高頻特性驗證，用於更高階應用。

在高速傳輸規格上，我們的研發量能已完整涵蓋主流介面，包括 USB4、USB 3.2 Gen2、eDP 1.4 與 Wi-Fi 7 等規格，相關阻抗控制與佈線損耗模型也已完成建立。

整體而言，CMI 的研發實驗室已能從材料、結構、佈線到量測提供一站式的高速 SI 設計能力，並已導入主流客戶專案開發流程，持續提升公司在高頻高速領域的競爭力

Q3: AI 火熱，公司是否有相關業務及進度？

PCB 業界看 AI 的需求分為雲端和邊緣兩大塊，。雲端 AI 主要推動資料中心帶動高階硬板需求，而我們軟板則將核心策略鎖定在邊緣運算（Edge AI）與終端應用。Edge AI 裝置，例如 AI PC、AI 手機、穿戴式裝置、機器人與自駕車等，這些產品均需要輕薄化、可攜帶、可折疊、高密度布線與更高的頻率性能，這些正是軟板技術與高頻高速軟板最能發揮價值的領域

目前高頻高速軟板開發案中的 80% 以上來自筆電平台，顯示我們已站在 AI PC 供應鏈的核心之一，另外穿戴式眼鏡等裝置也跟客戶持續進行開發中。

綜合來看，CMI 已具備切入 AI 邊緣裝置需求的技術能力與供貨能力，我們專注於將高頻高速和高可靠度這兩大技術累積，應用於 Edge AI 邊緣裝置，穩健抓住 AI 帶來的長期結構性成長機會。

Q4:泰國廠目前去瓶頸效益以及全製程規劃進度是？

我們泰國廠今年的主要工作為土建及機電建置，上個月已通過政府土建及消防驗收，目前進度為申請設備進口及生產許可。

我們目前的規劃是先進行軟板的後製程生產安排，此段亦是為降低我們昆山廠的後段生產瓶頸，預期後續直接交貨東南亞及海外的客戶群，我們均將移轉後製程作業至泰國廠生產及直接交貨。

泰國廠整個主要工廠建置為包含前製程及後製程一次蓋好，我們前製程原先的規劃是明年下半年開始量產，惟因目前整體需求不明，所以我們會視市場狀況及業務接單作靈活應對。